**Załącznik nr 2**

**Druga część zamówienia SDM-WS/30**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA InP SI**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. InP SI 2” DSP (dwustronnie polerowana) 50 sztuk

2. InP SI 3” DSP (dwustronnie polerowana) 50 sztuk

3. InP SI 4” DSP (dwustronnie polerowana) 20 sztuk

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena netto towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty
* Pmin - minimalna cena netto dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

1. **Termin wykonania zamówienia**

Do 3 miesięcy od daty zamówienia.

1. **Parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **InP półizolujące domieszkowane Fe** | Średnica 2” Grubość: 350±25 µmŚrednica: 50.8±0.4 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Orientatcja: | (100)±0.3o |
| Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
| Średnica 3”Grubość: 600±30 µmŚrednica: 76.2±0.3 mm | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
| Oporność: | >1E7 ohm cm |
| Średnica 4”Grubość: 625±25 µmŚrednica: 100±0.4 mm | EPD (średnia): | ≤4,000/cm2 max |
| Wykończenie powierzchni: | Dwustronnie polerowana:Strona 1: polerowana Strona 2: polerowana |
|  | Pakowanie: | Płytki 3” i 4”: ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |